

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-032

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,800 万元至 11,700 万元，同比增长 40.97%至 52.72%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8,700 万元至 9,700 万元，同比增长 46.85%至 63.73%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,800 万元至 11,700 万元，与 2023 年上半年同比增长 40.97%至 52.72%，与 2023 年下半年环比增长 46.97%至 59.22%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8,700 万元至 9,700 万元，与 2023 年上半年同比增长 46.85%至 63.73%，与 2023 年下半年环比增长 53.44%至 71.07%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润：7,661.14万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,924.39万元。

（二）每股收益：0.12元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司持续加大对先进封装相关技术、工艺的创新开发，以满足客户新业务与新产品的技术需求，并在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。

（二）持续拓展微型光学器件和WLO技术的市场化应用，稳步推进高集成度前照大灯等新应用领域的开发拓展。

（三）2024年上半年，以智能手机为代表的消费类电子领域库存水平逐步回归正常，市场需求呈现回暖趋势，公司在此领域封装业务也恢复增长。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年7月9日